

Title (en)

Electronic component, in particular for a chip inductor.

Title (de)

Elektronisches Bauteil, insbesondere für eine Chip-Induktivität.

Title (fr)

Composant électronique, en particulier pour une micro-inductance.

Publication

**EP 0177759 A1 19860416 (DE)**

Application

**EP 85111179 A 19850904**

Priority

DE 3433692 A 19840913

Abstract (en)

[origin: US4704592A] An electronic component such as a chip inductor, in particular an air core coil, RF choke and transformer is disclosed having a solid core portion (1) of the ferromagnetic or electrically nonconducting material, with a winding space to be wound in one or more courses and recessed relative to parallel end faces (2, 2) of the core portion. The end faces (2, 2) have dovetail-shaped cutouts (3, 3) located within the outside portion of these end faces for receiving tab-like electric contact elements (5, 5). These electrical contacts may be glued or wedged into these cutouts and retained therein under the action of resilient properties of the cutout elements.

Abstract (de)

Elektronisches Bauteil für eine Chip-Induktivität, insbesondere Luftspule, HF-Drossel und Übertrager, mit einem massiven Kernteil (1) aus ferromagnetischem oder elektrisch nichtleitenden Werkstoff, mit einem ein- oder mehrlagig bewickelbaren und gegenüber parallelen Stirnenden (2, 2) des Kernteils (1) abgesetzten Wickelraum und mit im Bereich dieser Stirnenden angeordneten schwalbenschwanzförmigen Aussparungen (3, 3) zur Aufnahme plättchenförmiger elektrischer Kontaktelemente (5, 5), die in diese Aussparungen eingeklebt, eingeklemmt oder unter der Wirkung federnder Eigenschaften der Kontaktelemente in diesen Aussparungen gehalten sind.

IPC 1-7

**H01F 15/10**; **H01F 41/10**; **H01F 17/04**

IPC 8 full level

**H01F 17/04** (2006.01); **H01F 27/02** (2006.01); **H01F 27/29** (2006.01); **H01F 27/36** (2006.01); **H01F 41/10** (2006.01); **H05K 7/12** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**H01F 17/045** (2013.01 - EP US); **H01F 27/292** (2013.01 - EP US); **H01F 41/10** (2013.01 - EP US); **H01F 2017/048** (2013.01 - EP US); **H01F 2027/295** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [Y] US 3735214 A 19730522 - RENSKERS J, et al
- [Y] DE 2454175 A1 19760526 - SACHSSE LOTHAR
- [A] US 3533054 A 19701006 - SPRIGGS ALBERT, et al

Cited by

DE19547091B4; EP1250828A4; GB2282271A; DE4332638A1; EP0702378A2; DE10031599B4; EP0675513A1; US5748065A; US5977857A; US6118364A; US6151770A; EP0270417A1; FR2606544A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0177759 A1 19860416**; **EP 0177759 B1 19900516**; DE 3577771 D1 19900621; JP H0564845 B2 19930916; JP S6171609 A 19860412; US 4704592 A 19871103

DOCDB simple family (application)

**EP 85111179 A 19850904**; DE 3577771 T 19850904; JP 19929985 A 19850909; US 76128885 A 19850801